



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

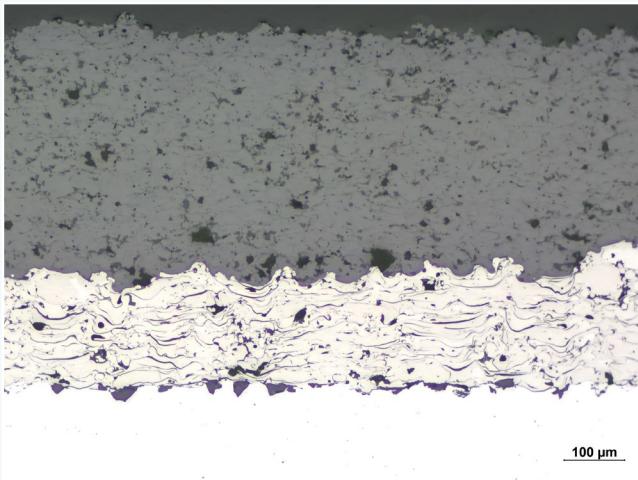
*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

** 对于其他陶瓷热喷涂涂层零件，可能需要增加氧化物抛光的时间。

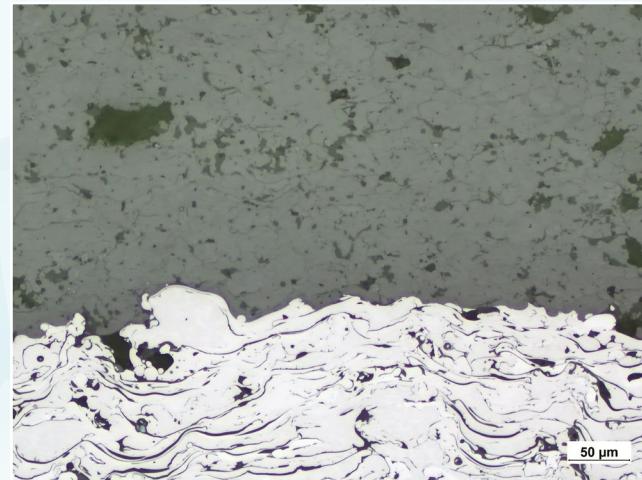


Aka-Brief #21 喷涂陶瓷涂层零件

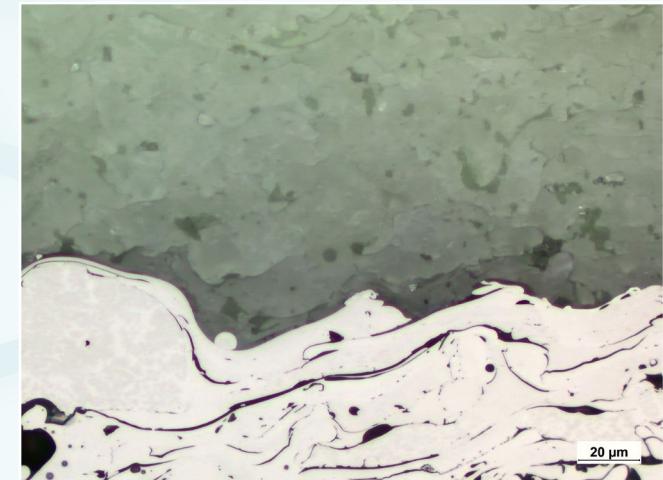
最终制样结果



陶瓷顶层和金属键合的热障涂层, 明场像, 100倍



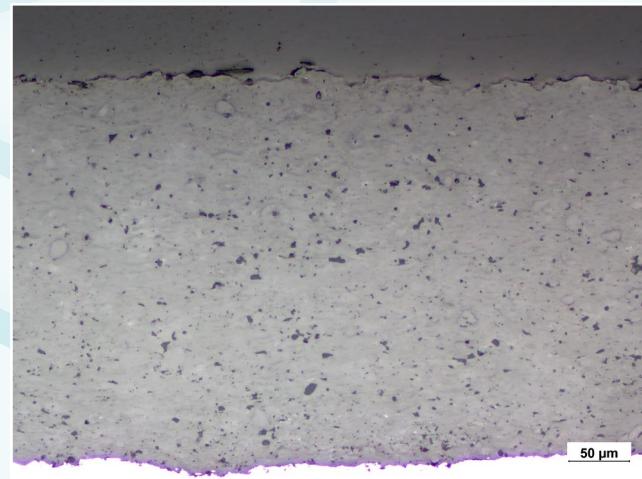
陶瓷顶层和金属键合的热障涂层, 明场像, 200倍



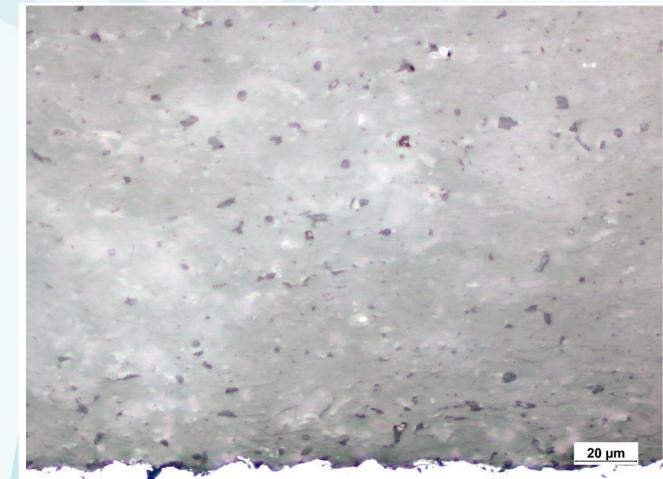
陶瓷顶层和金属键合的热障涂层, 明场像, 500倍



Al₂O₃ 钢基底上的铝涂层, 明场像, 100倍



Al₂O₃ 钢基底上的铝涂层, 明场像, 200倍



Al₂O₃ 钢基底上的铝涂层, 明场像, 500倍